



当日頂いた主な質問に対するご回答

Q1. 貴社の利益成長をけん引するのが、半導体関連事業であると認識しています。ただ、半導体市場は一定の周期で好況と不況を繰り返す「シリコンサイクル」が度々見られます。この先、半導体市況が悪化した際も安定した利益を創出できるのか、コメントいただけますか。

A1. 当社製品の仕向け先は食品や日用品、医療・医薬関連から半導体、光学関連分野まで、非常に多岐にわたっています。特定の業界に依存することなく、販売先が幅広い顧客層に及んでいることが特徴です。これは、一つの業界の市況に左右されることなく、安定的な収益を確保できるという当社の強みにもなっており、過去一度も営業赤字に陥ったことはありません。

Q2. 社名の由来を教えてください。

A2. 社名の由来は、リンケージ（結合）とテクノロジー（技術）の組み合わせです。なお、ロゴマークは、地球を表す楕円に LINTEC・LINKAGE（結合）・LOYALTY（誠実）の三つの「L」で表現したウェーブ（波）を組み合わせてデザインしています。これには世界を舞台に飛躍していこうという決意を込めています。

Q3. 半導体関連事業に関する設備投資実績や今後の設備投資計画について教えてください。

A3. 半導体関連粘着テープや積層セラミックコンデンサ関連テープの需要増加に対応すべく、前中期経営計画期間から総額約 250 億円の設備投資を行い、生産体制の強化を図ってきました。また、半導体関連装置についても中長期的に高い需要が見込めることから、装置の開発・製造を担う伊奈テクノロジーセンター（埼玉県）の再構築に乗り出しています。研究開発についても、EUV 露光機用 CNT ペリクルなど半導体関連について重点的に先行投資を行っており、前期には過去最高の 101 億円を投じました。

Q4. 為替感応度を教えてください。

A4. 為替感応度については、韓国ウォンや中国元、台湾ドルといったアジア通貨の影響も大きいと一概には言えませんが、対米ドル 1 円円安になると営業利益が年間で約 1~2 億円増加すると考えています。

Q5. 貴社の電子・光学関連セグメントは収益性が高いですが、半導体関連事業をさらに成長させるため、今後、新分野などへの展開を考えていますか。

A5. 成長領域に位置づける半導体関連事業では、EUV 露光機用 CNT ペリクルの量産体制確立に向けた取り組みを進めています。ペリクルはこれまで当社が開発してきた半導体製造の後工程で使われるテープとは異なり、半導体製造の前工程で使われる部材です。当社と

してはビジネス領域を拡大すべく挑戦を続けています。また近年、半導体デバイスにおいては、複数のチップを積み重ねて性能を高める三次元実装などパッケージング技術の進化が注目されています。当社はお客様との対話や関係機関・団体との意見交換などを積極的に行い、5-6年先の世界におけるデファクト・スタンダード（事実上の標準）を目指して、研究開発費などに資金を投じています。

Q6. 将来の会社の成長を担う人材育成や優秀な人材の採用への対応を教えてください。

A6. 当社は新製品・新事業の創出に打って出っていますが、こうした新規の事業化を成功に導くには、さまざまな経験や知見を持つ多様な人材が集い活躍する企業でなければならないと考えています。人材育成については、幅広い知識・センスに加え、専門性を持った「山型人材」の育成を目指した人材育成プログラムを導入しており、社員の意欲を最大限に引き出し、自発的なキャリアデザインを支援しています。また、高度専門人材の確保のため、一般社員に適用する資格等級制度とは分けた処遇を行う「CP制度（プロフェッショナル人材認定制度）」を設けているほか、当社独自のジョブ型雇用の枠組みも検討しています。

Q7. 環境意識の高まりからラベルレスといった新たな動きが市場で見受けられますが、こうした動きが本格化すれば、貴社の印刷情報材事業において影響は必至でしょうか。また、洋紙事業においても、昨今のペーパーレス化などのトレンドは事業に影響を与えていますか。

A7. 印刷情報材事業では、ラベルレスなどの市場への逆風があることも事実ですが、例えばプラスチック代替ラベル素材など環境配慮ニーズに応える各種製品の開発を強化し、新規需要の開拓に努めています。また、洋紙事業においては近年のデジタル化やペーパーレス化、郵便料金の値上げ影響などもあり、主力の封筒用紙については厳しい事業環境が継続していますが、脱プラ・減プラの潮流を踏まえて当社独自の抄紙技術を生かしたプラスチック代替高機能紙の開発・拡販などを進めています。具体的には、透明紙や生分解性ヒートシール紙の開発などのほか、耐油紙や耐水紙といった特殊紙製品のラインアップも拡充しています。

Q8. ペロブスカイト太陽電池への採用に向けた動きを教えてください。

A8. 当社のガスバリアフィルムは高い水蒸気のバリア性を有しています。その機能を生かして「ペロブスカイト太陽電池」や電子ペーパーをはじめとする製品において、内部のデバイスや基板などの部材を水蒸気による劣化から守ることができます。「ペロブスカイト太陽電池」への採用に向けては、展示会などを通じて業界トップクラスの性能を訴求しているほか、メーカー様とは個別具体的な提案活動を続けており、早期の収益化を目指しております。

Q9. 半導体関連事業について、競合他社比での優位性や顧客から評価される背景を教えてください。

A9. 当社は1986年に当時世界初の紫外線を照射して粘着力をコントロールする「UV硬化型ダイシングテープ」を開発して半導体関連分野に本格参入しました。こうした独自のUV照射技術などに優位性を発揮するほか、半導体関連粘着テープと半導体関連装置の両方を開発・提供しており、素材と装置のトータルソリューションでお客様の課題解決に貢献できます。また、代理店を通さない直販体制を敷き、世界の拠点にエンジニアが常駐することで、お客様のニーズを迅速かつ的確に捉えたり、お客様の課題に細やかに対応したりすることも可能にしています。当社製品が使用される半導体製造の後工程は、ウェハ上のチップを最終製品に仕上げる重要工程です。付加価値が高く、歩留まりが非常に重要な工程において、当社の高品質・高性能なハイエンド製品が長年にわたる供給実績の中でご評価いただいております。半導体の薄膜化・微細化が進む中で、今後も採用機会が増えることが予想されます。

以上